

Anlage zur FSPO vom 25.07.2018
für den Masterstudiengang
Microelectronics and Microsystems
an der TUHH in der dualen Variante
Studiengangsleiter/-in: Prof. Hoc Khiem Trieu
Gesamt: 150 LP
Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 1

Studienplan Master Microelectronics and Microsystems (IMPMM) Duale Variante

Konsolidierte Fassung
für die Studienanfängerkohorte:
WiSe22/23
gem. SDA-Beschluss vom: 19.10.2022
und Präsidiumsgenehmigung vom:
11.01.2023
ersetzt Version vom: 20.04.2022
Inkrafttreten: 01.10.2022
Außerkräfttreten: 30.09.2025

Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.

		Modul					Prüfung			Studienleistung		
Empf. Sem.	Modulname (deutsch / englisch)	Sprache	Modulverantwortung	Institut	P/WP (1)	GM/OM (2)	LP (4)	Note	Prüfungsart(3)	Verpflichtend	Art	Bonus (in %)
Kernqualifikation Pflichtbereich: 60 LP Wahlpflichtbereich: 42 LP												
1	Praxismodul 1 im dualen Master / Practical module 1 (dual study program, Master's degree)	DE	Dr. Haschke	0-SLS	P	GM	10	N	SA			
1	Digitale Nachrichtenübertragung / Digital Communications	DE / EN	Prof. Bauch	E-8	WP	GM	6	J	KL	J	SA	0
1	Entwurf Integrierter Schaltungen / Integrated Circuit Design	EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	KL			
1	Mikrosystemtechnik / Microsystem Engineering	EN	Dr. rer. nat. Kusserow	E-7	WP	GM	6	J	KL	N	RE	10
1	Mikrosystemtechnologie in Theorie und Praxis / Microsystems Technology in Theory and Practice	EN	Prof. Trieu	E-7	WP	GM	6	J	MP	J	FFST	0
1	Technischer Ergänzungskurs für IMPMM - Bereich ET (laut FSPO) / Technical Elective Complementary Course for IMPMM - field ET (according to Subject Specific Regulations)		Prof. Trieu	E-7	WP	OM	6	laut FSPO				
2	Praxismodul 2 im dualen Master / Practical module 2 (dual study program, Master's degree)	DE	Dr. Haschke	0-SLS	P	GM	10	N	SA			
2	Erweiterter IC-Entwurf / Advanced IC Design	EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	KL			
2	Halbleitertechnologie / Semiconductor Technology	DE / EN	Prof. Trieu	E-7	WP	GM	6	J	MP			
2	Mikrosystementwurf / Microsystem Design	EN	Dr. rer. nat. Kusserow	E-7	WP	GM	6	J	MP	J	SA	0
2	Technischer Ergänzungskurs für IMPMM - Bereich TUHH (laut FSPO) / Technical Elective Complementary Course for IMPMM - field TUHH (according to Subject Specific Regulations)		Prof. Trieu	E-7	WP	OM	6	laut FSPO				
3	Praxismodul 3 im dualen Master / Practical module 3 (dual study program, Master's degree)	DE	Dr. Haschke	0-SLS	P	GM	10	N	SA			
3	Projektarbeit IMPMM / Project Work IMPMM		Dozenten des SD E	E-7	P	GM	15	J	STA			
3	Seminar für IMPMM / Seminar for IMPMM	EN	Prof. Trieu	E-7	P	GM	3	J	RE			

		Modul					Prüfung			Studienleistung		
Empf. Sem.	Modulname (deutsch / englisch)	Sprache	Modulverantwortung	Institut	P/WP (1)	GM/OM (2)	LP (4)	Note	Prüfungsart(3)	Verpflichtend	Art	Bonus (in %)
1-3	Theorie-Praxis-Verzahnung im dualen Master / Linking theory and practice (dual study program, Master's degree)	DE	Dr. Haschke	0-SLS	P	GM	6	N	SA			
1-3	Betrieb & Management / Business & Management	DE / EN	Prof. Meyer	W-1	P	OM	6	Auswahl aus separat veröffentlichtem Katalog				
Vertiefung Communication and Signal Processing Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP												
1	Hochfrequenztechnik / Microwave Engineering	DE / EN	Prof. Kölpin	E-3	WP	GM	6	J	KL	J	FFST	0
1	Kommunikationsnetze / Communication Networks	EN	Prof. Timm-Giel	E-4	WP	GM	6	J	RE			
2	Satellitenkommunikation und Navigation / Satellite Communications and Navigation	EN	Prof. Bauch	E-8	WP	GM	6	J	MP			
2	Weiterführende Konzepte der drahtlosen Kommunikation / Advanced Concepts of Wireless Communications	EN	Dr. Grünheid	E-8	WP	GM	6	J	KL			
3	Ausgewählte Aspekte der Kommunikation und Signalverarbeitung / Selected Aspects of Communication and Signal Processing	EN	Prof. Trieu	SD-E	WP	GM	6	J	MP			
3	Bildverarbeitung / Image Processing	DE / EN	Prof. Knopp	E-5	WP	GM	6	J	KL			
3	COSIMA (Competition in Microsystem Application) / COSIMA (Competition in Microsystem Application)	EN	Prof. Trieu	E-7	WP	GM	6	J	FFA			
3	Digitale Audiosignalverarbeitung / Digital Audio Signal Processing	EN	Prof. Zölzer	E-8	WP	GM	6	J	KL			
3	Digitale Signalverarbeitung und Digitale Filter / Digital Signal Processing and Digital Filters	EN	Prof. Bauch	E-8	WP	GM	6	J	KL			
3	Medizinische Bildgebung / Medical Imaging	DE / EN	Prof. Knopp	E-5	WP	GM	6	J	KL			
Vertiefung Embedded Systems Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP												
1	Energieeffizienz in eingebetteten Systemen / Energy Efficiency in Embedded Systems	DE / EN	Prof. Kulau	E-EXK3	WP	GM	6	J	MP			
1	Rechnerarchitektur / Computer Architecture	DE / EN	Prof. Falk	E-13	WP	GM	6	J	KL	N	FFST	15
2	Eingebettete Systeme / Embedded Systems	EN	Prof. Falk	E-13	WP	GM	6	J	KL	J	FFST	10
2	Entwurf von Dependable Systems / Design of Dependable Systems	DE / EN	Prof. Fey	E-13	WP	GM	6	J	MP	J	FFST	0
2	Research Based Learning - Smart Sensing Applications / Research Based Learning - Smart Sensing Applications	DE / EN	Prof. Kulau	E-EXK3	WP	GM	6	J	SA			
2	Smart Sensors / Smart Sensors	DE / EN	Prof. Kulau	E-EXK3	WP	GM	6	J	MP			
2	Software für Eingebettete Systeme / Software for Embedded Systems	DE / EN	Prof. Renner	E-24	WP	GM	6	J	KL	N	TE	10

		Modul					Prüfung			Studienleistung		
Empf. Sem.	Modulname (deutsch / englisch)	Sprache	Modulverantwortung	Institut	P/WP (1)	GM/OM (2)	LP (4)	Note	Prüfungsart(3)	Verpflichtend	Art	Bonus (in %)
3	Ausgewählte Aspekte Eingebetteter Systeme / Selected Aspects of Embedded Systems	EN	Prof. Trieu	SD-E	WP	GM	6	J	MP			
3	COSIMA (Competition in Microsystem Application) / COSIMA (Competition in Microsystem Application)	EN	Prof. Trieu	E-7	WP	GM	6	J	FFA			
3	Fortgeschrittener Entwurf von Chip-Systemen (Praktikum) / Advanced System-on-Chip Design (Lab)	DE / EN	Prof. Falk	E-13	WP	GM	6	J	FFA			
3-4	Entwurf Digitaler Schaltungen / Digital Circuit Design	EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	MP			
Vertiefung Microelectronics Complements Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP												
1	Silizium Photonik / Silicon Photonics	EN	Dr. Lipka	E-7	WP	GM	6	J	MP			
1-2	Entwurf Digitaler Schaltungen / Digital Circuit Design	EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	MP			
2	EMV I: Kopplungen, Gegenmaßnahmen und Prüfverfahren / EMC I: Coupling Mechanisms, Countermeasures and Test Procedures	DE / EN	Prof. Schuster	E-18	WP	GM	6	J	MP	J	RE	0
2	Faseroptik und Integrierte Optik / Fibre and Integrated Optics	EN	Prof. Eich	E-12	WP	GM	4	J	KL			
2	Optoelektronik I - Wellenoptik / Optoelectronics I - Wave Optics	EN	Dr. Petrov	E-12	WP	GM	4	J	KL			
2	Praktischer Schaltungsentwurf - Digital / Laboratory: Digital Circuit Design	EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	FFA			
3	Ausgewählte Aspekte der Mikroelektronik und Mikrosysteme / Selected Aspects of Microelectronics and Microsystems	EN	Prof. Trieu	SD-E	WP	GM	6	J	MP			
3	COSIMA (Competition in Microsystem Application) / COSIMA (Competition in Microsystem Application)	EN	Prof. Trieu	E-7	WP	GM	6	J	FFA			
3	EMV II: Signalintegrität und Spannungsversorgung elektronischer Systeme / EMC II: Signal Integrity and Power Supply of Electronic Systems	DE / EN	Prof. Schuster	E-18	WP	GM	6	J	MP	J	RE	0
3	Mixed-signal Schaltungsentwurf / Mixed-signal Circuit Design	EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	KL	J	FFST	5
3	Optoelektronik II - Quantenoptik / Optoelectronics II - Quantum Optics	EN	Dr. Petrov	E-12	WP	GM	4	J	KL			
3	Praktischer Schaltungsentwurf - Analog / Laboratory: Analog Circuit Design	EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	FFA			
Abschlussarbeit Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP												
4	Masterarbeit im dualen Studium / Master thesis (dual study program)		Professoren der TUHH	0-TUHH	P	GM	30	J	AB			

Legende:

¹P=Pflicht, WP=Wahlpflicht

²GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul

³Kl=Klausur, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFST=Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, MP=Mündliche Prüfung, RE=Referat, STA=Studienarbeit, AB=Abschlussarbeit, SA
lt. FPO=Schriftliche Ausarbeitung (laut FPO), TE=Testate

⁴LP=Leistungspunkte

⁵VL=Vorlesung, SE=Seminar, GÜ=Gruppenübung, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PR=Praktikum, HÜ=Hörsaalübung

⁶DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch

⁷SWS=Semesterwochenstunden